

제12회 태성에스엔이 전기전자반도체 세미나

AI 기반 차세대 반도체 산업 동향과 CAE 최적화 전략

일자 : 2025.03.27 (목) 10:30 - 16:50 장소 : 한국과학기술회관 대회의실1

AGENDA

발표제목을 클릭해 주세요.

TIME	THEME	SPEAKER
10:30 - 10:40	인사말	태성에스엔이 중소벤처기업연수원
10:40 - 11:20	AI 기반 반도체 산업의 동향	김주호 교수 서강대학교
11:20 - 11:50	AI를 이용한 3차원 전력 전자 모듈에 대한 온도 예측	권기태 수석 태성에스엔이
11:50 - 12:20	LPV기반 열저항 행렬을 이용한 2.5D/3D-IC 패키지의 열특성화 모델링 평가및 검증 3/27 ONLY	이명훈 프로 Ansys Korea
12:20 - 13:30	Lunch	
13:30 - 14:00	반도체 패키징 인터커넥션 기술과 CAE 3/27 ONLY	고용호 센터장 생산기술연구원
14:00 - 14:30	Comparative Study of 2.5D Interposer Simulation and Measurement Data 3/27 ONLY	이용택 수석 스태츠칩팩코리아
14:30 - 15:00	Metamodel을 이용한 PCB/PKG/Interposer routing 자동 최적화	김태진 이사 Ansys Korea
15:00 - 15:20	Break & Networking	
15:20 - 15:50	Electromigration에 의한 PCB/PKG 수명 예측 해석	배현진 매니저 태성에스엔이
15:50 - 16:20	ROM을 활용한 수냉식 인버터 열유동 해석	이예준 매니저 태성에스엔이
16:20 - 16:50	PCB/PKG 뒤틀림(Warpage) 해석을 위한 연성 해석 방법 소개	김창환 팀장 태성에스엔이